

CASE、自動化、シェアリング、電動化、、、自動車の技術革新を実現する高分子実装材料とは
最先端のエレクトロニクスを担う次世代半導体の高機能化を可能とする半導体実装用材料を網羅的に解説



【Live配信(リアルタイム配信)】

カーエレクトロニクス用高分子実装材料
(封止・パッケージ材、多層配線基板、高熱伝導性接着シート材)の
設計、評価と最新技術動向



| | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------|
| 日時 | 2020年7月29日(水) 10:30~16:30 | 会場 | Live配信セミナー ※会社・自宅にしながら学習可能です※ |
| 受講料 | 49,500円⇒テレワーク応援キャンペーン 【Live配信/WEBセミナー受講限定】 1名申込みの場合:受講料 定価:35,200円/S&T会員 33,440円 ※ 同一企業から複数名S&T会員で受講される場合は本割引ではなく、「2名同時申込みで1名分無料」割引を適用させていただきます。 | 資料付 | |

講師 横浜国立大学 工学研究院 産学連携研究員(元教授)工学博士 高橋 昭雄 氏 【横浜市立大学 客員教授】

趣旨 クラウドコンピューティングを通してIoT、AIと多種多様な情報が瞬時に飛び交い、自動車までもが情報交換のツールとして重要な位置を占めつつある。CASEと略称されるコネクテッド、自動化、シェアリング、電動化といった技術革新によってクルマの概念が大きく変わろうとしている。これらは、最先端の半導体及び実装材料技術を駆使したエレクトロニクス機器に支えられている。
本講座は、最先端のエレクトロニクスを担う次世代半導体の高機能化を可能とする半導体実装用材料、具体的には封止材、多層配線基板、高熱伝導性接着シート材に適用しうる熱硬化性樹脂を中心とする高分子材料を対象とする。5G施行から6Gを見据えた高周波領域での低誘電特性材料そして、次世代のパワー半導体モジュールを実現するための高耐熱、高熱伝導性材料である。分子設計から実用化に向けての材料設計及び特性評価について解説する。

| | | |
|--------------|---|--|
| プログラム | 1. エレクトロニクス実装技術と高分子材料 (1)マイクロエレクトロニクス実装技術の動向 (2)パワーエレクトロニクス実装技術の動向 (3)高分子材料とその役割 | 4. パワーエレクトロニクス用高分子材料 (1)次世代パワー半導体(SiC)と実装技術 (2)パワー半導体実装用高分子材料と要求される特性 (3)SiC等大電流パワーモジュール実装材料の信頼性評価 |
| | 2. エレクトロニクス実装と高分子材料 (1)エポキシ樹脂、ポリイミドの種類と特徴 (2)半導体封止材 製造方法、特性と評価、課題と対策 (3)多層プリント板 製造方法 (プリント基板、ビルドアップ材他)、特性と評価、課題と対策 (4)エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂の新たな展開 低誘電特性、感光性、ポリマーアロイ、ナノコンポジット化等による機能性付与 | 5. 耐熱性高分子材料 (1)物理的耐熱性と化学的耐熱性 (2)耐熱性高分子材料の設計 |
| | 3. 高分子材料に要求される物理特性とアプローチ (1)低誘電率、低誘電正接樹脂へのアプローチ | 6. スーパーエンジニアリングプラスチック 7. 耐熱性熱硬化性樹脂 8. 新規耐熱性樹脂を実用化する際の見逃しがちな現象と対策 各項目で具体例とQ&Aを交えながら解説する。 <input type="checkbox"/> 質疑応答 <input type="checkbox"/> |

本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。予め「Zoom」のインストールが可能か、接続可能か等をご確認ください。
セミナー資料は電子ファイルでの配布、郵送のいずれかになります。詳細はホームページをご確認下さい。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,750円)
※2名様ともS&T会員登録をいただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B200729 (カーエレ用高分子)

| | | | |
|------------|---------------------------------|--|--|
| 会社名 団体名 | | | |
| 部署 | | | |
| 役職 | 〒 | | |
| ふりがな | 住所 | | |
| 氏名 | | | |
| TEL | FAX | | |
| E-mail | ※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。 | | |

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内
 E-mail希望・登録済み } S&T会員価格を
 郵送希望・登録済み } 適用いたします。
 希望しない } (E-mailアドレス必須)

お支払方法
 銀行振込 (振込予定日 月 日)
 当日現金払い

通信欄

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3~6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日~2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、事情により中止になる場合がございます。

S&T サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍

サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
http://www.science-t.com